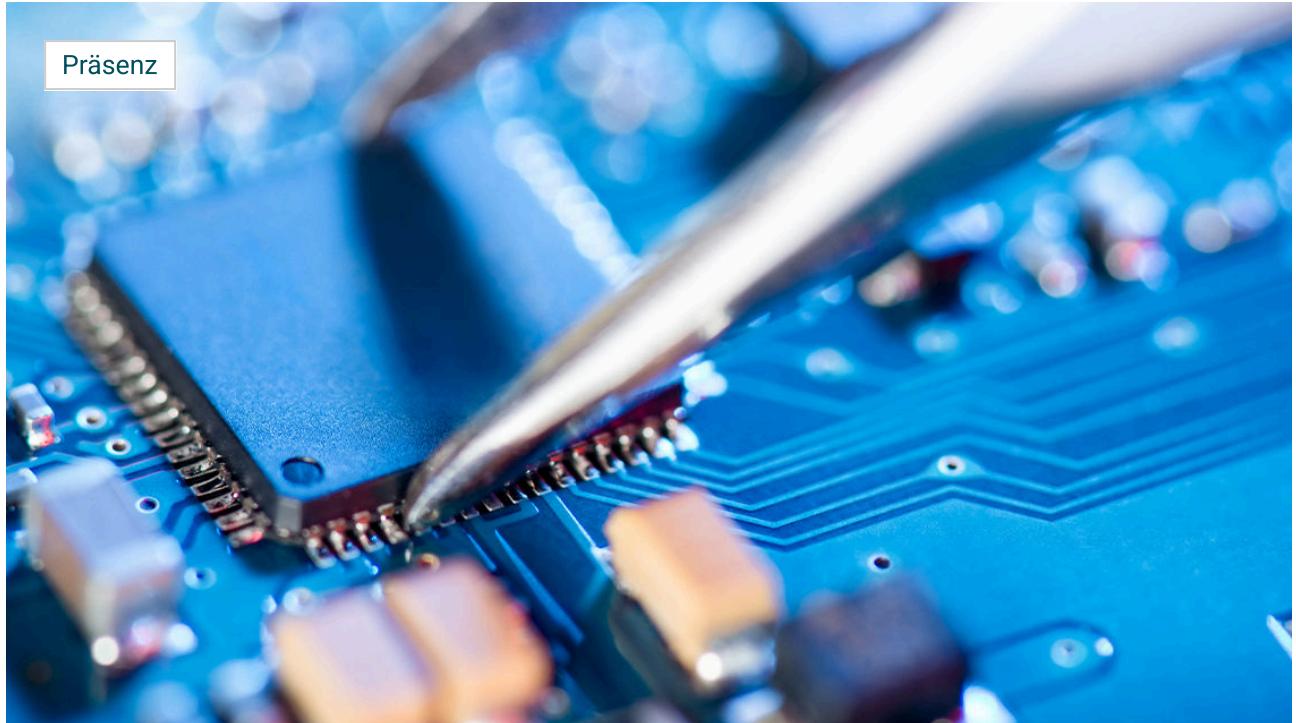


Konstruieren von mechatronischen Produkten

Die optimale Integration von Elektroniktechnologien in Gehäusen



Termin

Di. 05.05.2026, 09:00 Uhr –
Mi. 06.05.2026, 16:00 Uhr

Teilnahmegebühren

Präsenz-Teilnahme Für HDT-Mitglieder	1.250,00 €*
	1.125,00 €*

Veranstaltungsort

Haus der Technik e.V.
Hollestr. 1
45127 Essen



Weitere Informationen und die
Möglichkeit zur Online-Buchung
Ihrer Teilnahme finden Sie auf der
[Veranstaltungs-Webseite](#).

Stand: 23.07.2025, 09:05 Uhr

Konstruieren von mechatronischen Produkten

Zum Thema

Der Konstrukteur in der Elektronikentwicklung hat zwei Seiten zu beachten: die mechanische und die elektrische. Er hat die mechanische Befestigung, Dichtigkeit und ggfs. Entwärmung in seinem Gehäuse im Blick. Dabei bedient er sich seinem Wissen aus seiner mechanischen Ausbildung/Studium. Leider stößt er dabei an seine Grenzen, denn der Umgang und die Integration mit Elektronik ist neues Fachgebiet. Dieses Seminar hilft ihm, den vielfach unbekannten Bereich Elektrik/Elektronik aus seiner Sicht zu verstehen und seinen Handlungsspielraum zu lernen.

Zielsetzung

Lernen Sie das Handwerkszeug als Elektronikkonstrukteur, damit Sie sich mit allen Elektroniktechnologien auskennen und sie optimal im Gehäuse unterbringen können. Statt Schaltpläne zu erstellen, lernen Sie im Seminar die verschiedenen Elektronik-Technologien (u.a. starr, flex, MID, Additiv) aus der Sicht des Mechanik-Entwicklers kennen. Im richtigen Fachjargon werden Techniken wie Konstruieren mit Luft- und Kriechstrecken, Elektronikbefestigung, Anschlusstechnik, Dichtigkeit und Entwärmung verwendet.

Programm

06.05.2026

10:30–10:45 Kaffeepause

10:45–12:30 Anschlusstechnik (Fortsetzung)

12:30–13:30 Mittagspause

13:30–15:00 Dichtigkeit und Entwärmung

15:00–15:15 Kaffeepause

15:15–16:00 Dichtigkeit und Entwärmung (Fortsetzung)

09:00–09:30 Rückblick erster Tag

09:30–10:30 Anschlusstechnik

05.05.2026

10:45–12:30 Gehäusekonstruktion und Grundlagen Elektronik (Fortsetzung)

12:30–13:30 Mittagspause

13:30–15:00 Leiterplattenbefestigung

15:00–15:15 Kaffeepause

15:15–17:00 Leiterplattenbefestigung (Fortsetzung)

09:00–09:15 Begrüßung

09:15–10:30 Gehäusekonstruktion und Grundlagen Elektronik

10:30–10:45 Kaffeepause
